

深圳联宏达电子材料有限公司

电话：0755-23315767 传真：0755-23315737
地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区金元二路 25 号
T125 系列导热硅胶-材质说明

T125 系列 导热硅胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙，它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个 PCB 传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

产品特性：

- 》良好的热传导率: **1.25W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

产品应用：

- 》散热器底部或框架
- 》LED 液晶显示屏背光管
- 》LED 电视 LED 灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》RDRAM 内存模块
- 》微型热管散热器
- 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件
- 》便携式电子装置
- 》半导体自动试验设备

T125 系列特性表									
产品名称	T125-U	T125-E	T125-S	Visual	厚度		热阻@10psi (°C-in² /W)		
颜色	各种颜色			Visual			TIF™200-U	TIF™200-E	TIF™200-S
结构&成分	陶瓷填充 硅橡胶			***	12 mils	0.304mm	0.73	0.75	0.76
					20 mils	0.508mm	0.95	0.97	0.98
比重	1.75g/cc			ASTM D297	30 mils	0.762mm	1.17	1.18	1.20
					40 mils	1.016mm	1.28	1.30	1.32
热容积	1 l/g-K			ASTM C351	50 mils	1.270mm	1.47	1.49	1.52
					60 mils	1.524mm	1.68	1.70	1.73
硬度	25	30	45	ASTM 2240	70 mils	1.778mm	1.86	1.88	1.91
	Shore 00				80 mils	2.032mm	2.05	2.08	2.11
抗张强度	425 psi			ASTM D412	90 mils	2.286mm	2.21	2.24	2.28
					100 mils	2.540mm	2.37	2.40	2.44
使用温度范围	-50 to 200℃			***	110 mils	2.794mm	2.49	2.53	2.57
					120 mils	3.048mm	2.65	2.69	2.73
击穿电压	>5500 VAC			ASTM D149	130 mils	3.302mm	2.82	2.86	2.91
					140 mils	3.556mm	2.95	3.00	3.05
介电常数	5.5 MHz			ASTM D150	150 mils	3.810mm	3.08	3.12	3.17
					160 mils	4.064mm	3.20	3.25	3.30
体积电阻率	4.0X10 ¹⁰ Ohm-meter			ASTM D257	170 mils	4.318mm	3.34	3.39	3.44
					180 mils	4.572mm	3.44	3.49	3.55
防火等级	94 V0			equivalent UL	190 mils	4.826mm	3.52	3.57	3.63
					200 mils	5.080mm	3.62	3.68	3.73
导热率	1.25 W/m-K			ASTM D5470	Visua l	ASTMD751	ASTM D5470		